(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[4]
A23L 1/217

(11) 공개번호 특1988-0010692
(43) 공개일자 1988년10월24일

(21) 출원번호 특1988-0003041
(22) 출원일자 1988년03월22일

(30) 우선권주장 62-69769 1987년03월24일 일본(JP)
(71) 출원인 하우스 쇼꾸힌 고오교오 가부시키가이샤 오오쓰 구니히꼬
일본국 오오사까후 히가시 오오사까시 미꾸리야 사까에마찌 1죠오메 5반 7고오
(72) 발명자 마쯔무라 야쓰시
일본국 나라껜 나라시 우꾜오 5-9 헤이조오우꼬오 단찌 21-503
미즈구찌 다께시
일본국 나라껜 나라시 쯔루마이니시마찌 2-16 에꾸세루하이쯔 쯔루마이 에이 302
마쓰이 후미오
일본국 오오사까후 모리구찌시 사이고도오리 2-16
(74) 대리인 장용식

심사청구 : 있음

(54) 과일칩의 제조방법

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

과입칩의 제조방법

[도면의 간단한 설명]

제 1 도는 본 발명의 방법을 실행하는데 사용될 수 있는 특정장치의 실례를 예시하는 개략도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1

과일칩 제조방법에 있어서, (a) 바나나를 작은 조작으로 절단하는 단계;(b) 바나나 조각을 온도조절 치리를 행하는 단계;(c) 정상 압력에서 예정된 감소 압력으로 압력을 급히 강하함으로써 온도조절된 바나나 조각을 팽창하는 단계;와 (d) 팽창된 바나나 조각을 감압하에서 가열하는 단계로 이루어지며, 절단하는 단계(a)에서부터 단계(c)에서 압력의 강하를 완료하기 까지 소요된 시간이 20분 이하인 것을 특징으로 하는 과일칩의 제조방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 단계(a)에서 바나나가 3 내지 5㎜ 두께를 지니는 작은 조각으로 절단되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 3

제 1 항에 있어서, 단계(b)에서, 절단 바나나의 온도를 5 내지 20℃로 조정하도록 온도조절처리가 실행되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 4

제 1 항에 있어서, 상기 단계(c)에서 예정된 감소 압력이 150 내지 500Pa 범위이며, 압력감소가 1분재에 완료되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 5

제 1 항에 있어서, 팽창처리가 압력을 예정된 감소압력으로 급히 강하시킨 다음 5 내지 15분 동안 감소된 압력에서 바나나 조각을 유지시킴으로써 실행되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 6

제 1 항에 있어서, 상기 단계(c)에서 팽창된 바나나 조각은 단계(c)내에서의 압력보다 낮은 감소된 압력하에서 가열되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 7

제 6 항에 있어서, 사익 단계(d)에서 가열동안의 압력이 20 내지 50Pa 범위인 것을 특징으로 하는 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1

